

California Micro Devices wird auf der IMAPS-Konferenz in Scottsdale einen WLCSP-Beitrag vorstellen und eine Podiumsdiskussion veranstalten

SCOTTSDALE, Arizona, 18. März/PRNewswire/ --

- Der Beitrag von CMD zu den neuen Repassivierungsverfahren wird im Rahmen der Programmschiene des WLCSP-Forums präsentiert

California Micro Devices gab bekannt, dass das Unternehmen auf der vom 17. bis 20. März 2008 im Radisson Fort McDowell Resort und Casino in Scottsdale, Arizona, stattfindenden 4. internationalen IMAPS-Jahreskonferenz und Ausstellung zum Thema Bauteilgehäuse einen technischen Beitrag zum neuen Repassivierungsverfahren von CSP, das auf die Minimierung parasitärer Elemente in ASIP(TM)-Bauteilen (Application Specific Integrated Passive(TM)) ausgerichtet ist, vorstellen wird. Die Präsentation erfolgt im Rahmen einer Reihe technischer Beiträge zum Thema „Wafer Level Chip Scale Package Board“-Zuverlässigkeit, die vom WLCSP-Forum (Wafer Level Chip Scale) unterstützt werden.

Neues CSP-Fertigungsverfahren verbessert ASIP-Leistung und -Zuverlässigkeit

Der Beitrag mit dem Titel „A Novel Re-Passivation/RDL CSP Technology for Minimizing Parasitic Elements in ASIP Products“ beschäftigt sich mit der Rolle parasitärer Kapazitäten bei WLCSP-Verfahren und bietet ein optimales Repassivierungs- und RDL-Verfahren für WLCSP, das zu einer höheren elektrischen Leistungsfähigkeit bei auf CSP beruhendem Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD - electrostatic discharge) und elektromagnetischen Interferenzfiltern (EMI) führen und die thermo-mechanische Zuverlässigkeit verbessern kann. Der Beitrag wird von Dr. Umesh Sharma, Leiter Fertigungsanlage und technischer Betrieb bei California Micro Devices, vorgestellt. Nach der Konferenz kann der Beitrag von der Website des Unternehmens unter <http://www.cmd.com/applications/papers.php> bzw. von der Website des Wafer Level Chipscale Forums unter <http://www.wlcspforum.org> heruntergeladen werden.

Podiumsdiskussion zur WLCSP-Zuverlässigkeit

Im Zuge der IMAPS- Konferenz zum Thema Bauteilgehäuse wird das WLCSP-Forum zwei Podiumsdiskussionen zur Zuverlässigkeit von WLCSP-Boards veranstalten. Die erste Sitzung findet am 18. März statt und wird eine Präsentation der neuen Repassivierungs- und RDL CSP Technologie von California Micro Devices und vier weitere technische Beiträge bieten, die von Mitgliedern des WLCSP Forums verfasst wurden und auch von ihnen vorgestellt werden. Die Podiumsdiskussion wird von Kyle Baker, Vice President Marketing von California Micro Devices und Vorsitzender des WLCSP-Forums, moderiert.

Informationen zu California Micro Devices Corporation

California Micro Devices Corporation ist ein führender Anbieter anwendungsspezifischer Analog- und Mixed-Signal-Halbleiterprodukte für

Mobilgeräte, Unterhaltungselektronik und PCs. Zu den wichtigsten Produkten gehören Schutz-ICs für Mobilgeräte, digitale Unterhaltungselektronik wie z. B. Digital-Fernseher und PCs sowie Analog- und Mixed-Signal-ICs für Displays in Mobilgeräten. Einzelheiten zum Unternehmen und zu seinen Produkten stehen unter <http://www.cmd.com> zur Verfügung.

ASIP und Application Specific Integrated Passive sind Handelsmarken von California Micro Devices Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers.

Website: <http://www.cmd.com>

Quelle: California Micro Devices

Richard Haas von California Micro Devices, Tel.: +1-408-934-3108, E-Mail: richardh@cmd.com